



集成电路(无锡)创新发展大会

新生万象 链动世界

INTEGRATED CIRCUIT (WUXI) INNOVATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE



1300家海内外企业、超7万平方米展馆，一场展会成为行业“风向标”

太湖之滨千企共话“芯”生态

太湖之滨，群贤毕至。8月31日，为期3天的第十四届半导体设备材料及核心部件展在锡开幕，吸引超1300家海内外产业链企业齐聚，展陈空间超7万平方米，参展规模、展区面积再攀新高。这场被业内视为行业“风向标”的年度盛会，在集中展示技术成果的同时，也折射出半导体产业从“关键突破”迈向“生态构建”的深层脉动。

展会现场人头攒动。今年展馆扩容至“7+1”个，总面积较上届增长16.7%，为历史之最。参展企业覆盖国际、国内多家知名龙头企业，其中上市企业105家，专精特新企业93家，江苏省内参展企业237家、无锡本地企业78家，海外展商占比达16%，预计吸引近12万人次观展。高回头率与强势的“扩容”速度，折射出展会行业信任度。其中不少企业已是数次参展，每次均携新技术、新方案而来，年复一年，已形成技术碰撞、方案迭出的良性生态。

国内产品线覆盖最全、技术积淀最

深的半导体装备集团北方华创，此番带来三维集成及先进封装领域设备及工艺解决方案，龙头企业成为展会的“定海神针”；中科飞测亮出检测设备、量测设备、智能软件三大核心产品，占质量控制设备市场超70%，打破了国际设备厂商对国内市场长期垄断的局面，国产突破底气十足；而在细分赛道上，星微科技专注超高真空运动平台，产品真空度可达到1×10⁻¹⁰mBar，应用规模虽小、专业属性极强……展出内容覆盖装备整机、核心部件、关键工艺、量检测等多个维度，反映了无锡在全产业链上的核心引力。

技术能否落地，订单才是最好的试金石。无锡邑微电子科技股份有限公司今年再度携多项突破性技术参展。企业瞄准未来市场，与国内头部AR光波导企业合作，联合进行工艺升级；同时探索开发Micro-LED领域铝镓铟磷高温刻蚀方式，一举打破对海外设备的依赖，为国产设备拓展了更多应用场景。目前两大技术方向均已斩获成效，为企业贡献了约40%订单。此外企业自主研发的12英寸刻

蚀设备已进驻华虹无锡12英寸产线，并取得复购，吸引不少新客户签订订购。“每年的展会都能汇聚众多供应链与客户资源，希望借此接触优质供应链企业，增进了解；同时获得更多曝光，挖掘潜在合作机会。”企业销售二部总经理倪林益介绍。

展会不仅能够秀出技术，还能论道产业。今年展会共设置半导体产业CEO论坛、2026半导体材料发展(无锡)论坛等20余场论坛，围绕半导体设备、关键材料、先进工艺等产业格局与技术前沿议题，探索产业高质量发展的新路径。如何实现合作共赢，打造健康的供应链体系？人工智能影响下，半导体产业将迎来怎样的新机遇？新器件、新工艺，怎样推动新材料、新设备创新发展？一场场头脑风暴激荡出智慧涟漪。

“每年参会都能够了解行业新动态，看到更多细分赛道带来的新增长点。”安捷伦科技市场总监郑欣是展会常客，每届分论坛都是他的“打卡地”。企业主营的实验室仪器属于通用型设备，能够服务芯片、高纯试剂、

封装等半导体全流程。通过行业论坛，企业得以了解未来一段时间内半导体行业的宏观趋势，分析国产替代、供应链自主可控进程，进而谋划加强本地研发制造布局。

行业的长远发展，离不开人才这一创新源头。展会期间，清华大学、东南大学、江南大学等30所高校组团参加，开展企业对接，共同搭建起产学研用深度融合的桥梁。西安电子科技大学将展会作为校企联动的重要舞台，主动对接行业龙头企业，探索更广泛范围的产业合作。“依托学校拥有的全国重点实验室等平台，可对接全国乃至全球领先的技术资源，实现校内负责前沿研发，企业负责规模化量产。”学校校友、上海格晶半导体有限公司总监孙斌介绍，由西电孵化的格晶半导体目前年销售额已达数亿元。借助此次在锡参展契机，学校将发布联合实验室、研究院等10类校企合作模式，对接更多行业重点企业。

(龚燕 文/钦嫣 摄)



锡山崛起电子化学材料产业高地

本报讯 8月31日，锡山区电子化学品与先进材料创新发展交流会举行，近百位半导体产业链上下游的企业家、投资人和行业专家齐聚一堂。这场精准对接集成电路上游材料需求的行业盛会，既是锡山区新材料产业园的一次推介，也是东港镇向高端电子材料赛道进阶的全新起点。10余年深耕，该园区已成为无锡城区唯一的省级化工园区，去年实现营收138.7亿元，亩均税收位居全省前列。一个“专精特新”的电子化学材料产业高地正在锡山加速成形。

锡山新材料产业园聚焦电子化学品、高分子材料两大方向，同步拓展生物医药原料赛道，产业定位始终与城市发展战略同频。“目前园区已集聚3家上市企业、1家全国民营企业500强，以及4家国内细分行业领军企业。”东港镇相关负责人介绍，上半年，园区企业营收同比增长21.3%，利润增长59.3%，展现出强劲的发展势头。

活动中，一批协会战略合作项目、科创项目、合作基金相继落地。“我们不

走大而全的路线，就是要把稀缺的园区空间用在集成电路最急需的材料赛道上。”园区相关负责人表示，随着确成硅基一体化新材料项目、长瀚半导体高纯化学品项目接连落地，园区正加速形成龙头引领、梯队协同的电子化学材料产业集群。现场，长瀚晶创(无锡)新材料有限公司董事长李敏表示，园区定位与长瀚在高纯半导体材料领域的战略方向高度契合，让企业未来的协同研发、降本增效充满信心。

硬核配套是吸引企业落地的关键。据了解，自建园以来，东港镇累计投入超16亿元，打造了一套覆盖基础设施、安全管控、绿色环保等的全维度保障体系，让企业能够“轻装上阵”专注发展。配套日处理1万立方米的专业化工业污水处理厂，形成三级突水污染应急防控体系；实现全域集中供热，大幅节省企业建设与运维成本；架设双回路独立电源，充分保障化工装置连续化稳定运行……不仅如此，在服务上，从项目审批到人才引育，东港镇提供全周期护航。(尹晖、张子秋)

惠山精准卡位汽车芯片应用端

本报讯 “软件定义汽车”正为集成电路产业链带来巨大的市场增量。8月31日，2026汽车芯片产业创新生态会议在惠山区举办。作为集成电路(无锡)创新发展大会的子活动，本次会议围绕开发国产芯片和新型电子气架构应用解决方案、推动车规芯片和软件在机器人领域应用等议题展开，汇聚产业链上下游资源开展供需对接交流，吸引汽车、芯片等相关企业近160人参加。

汽车及零部件是惠山区首个冲刺千亿元的产业集群，也是工业经济的强力增长极。去年，全区电子信息产业集群规模突破468亿元，其中规上集成电路产业实现营收66亿元，同比增长15.6%。以万寿湖集成电路产业园等核心载体为支撑，集聚先进封装、光电融合、AI及智能终端等特色产业，走出一条“车芯+算力+AI”融合发展路径。

推动汽车产业生态建设是本次大会的重要议题。会上，《2026中国汽车芯片供给手册》《2026机器人芯片

供给手册》2项成果正式发布。惠山区与中国汽车芯片产业创新战略联盟正式合作签约，双方旨在借助本次战略合作搭建汽车芯片交流平台，汇聚优质产业资源。中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚真表示，汽车芯片是智能汽车的技术底座，无锡智能网联汽车产业雄厚，有望为芯片上游端提供更多应用场景。

人工智能正重塑汽车芯片产业格局，并加速渗透跨界应用创新及机器人场景拓展。深圳大学半导体制造研究院副院长王序进介绍，全球汽车芯片与AI芯片需求激增，车规级芯片对安全性要求极高，对国产大模型与算法架构提出了新要求。在“锲定律”下，半导体产业需从单纯追求线宽转向系统级优化，汽车芯片国产化仍有巨大空间，但面临严苛的车规级安全测试门槛。惠山区相关负责人表示，将持续推动算力技术与汽车芯片、智能座舱、自动驾驶深度融合，为汽车芯片产业发展提供最优土壤、最强支撑。(裴培兴、汤蕾)

第四代半导体未来产业沙龙活动举办

本报讯 8月31日下午，“资本赋能·芯启未来”第四代半导体未来产业沙龙举办，来自全国各地的第四代半导体行业专家、企业代表、投资机构及产业从业者等近300位代表参会，副市长周文栋、省委金融委员会办公室副主任钱东平、上海证券交易所副总理吕昊出席活动并致辞。

第四代超宽禁带半导体是全球角逐的未来产业新赛道，目前正处于技术商业化、产业化落地的关键窗口期。本次活动搭建政府、科研院所、

产业企业、资本市场多方对话交流平台，发挥资本市场资源配置功能，助力第四代半导体领域产学研协同攻关、产融深度融合。

周文栋在致辞中表示，无锡集成电路产业根基扎实，具备抢占第四代半导体前沿赛道的创新优势。他希望参会行业专家建言献策，推动优质科研成果在锡落地转化；科创企业紧抓产业机遇，攻坚核心技术，突破产业瓶颈；各类投资机构精准对接产业需求，加大硬科技领域投资力度。(陈文君)

江苏省端侧AI芯片对接交流暨2026无锡AI芯片新品发布活动举行

推动人工智能走进产业实体

本报讯 8月31日下午，江苏省端侧AI芯片对接交流暨2026无锡AI芯片新品发布活动在无锡国际会议中心举行。中国科学院工业人工智能研究所、芯朋微、拓易科技、至讯创新等全省80余家企业、机构携创新产品和技术需求出席，共同推动人工智能从云端数据中心走进产业实体环节。

当前，AI应用加速向手机、汽车、可穿戴设备、机器人等海量终端设备下沉，端侧AI芯片已成为我国掌握物理空间人工智能发展主动权、实现终端产业自主可控的战略高点。“一方面，人工智能改变了芯片发展方式，另一方面其本身也正从数字空间加速走向物理空间，对端侧智能计算提出更高要求。”中国科学院工业人工智能研究所副所长陈云霁表示，行业亟需新的创新方式，让需求能够参与到技术、定义、产品及价格设计等过程中去。

“这是一款1-2TOPS算力、高

实时性、高可靠性、低功耗的工业/机器人端侧AI实时处理芯片。”无锡摩芯半导体有限公司展示了其第二代端侧AI控制芯片产品能力。企业CTO甘焱林介绍，第一代产品侧重端侧传感增强和汽车应用方向，目前已在力传感器、汽车热管理、智能悬架以及检测具身机器人等场景形成落地方案。此次发布的第二代芯片将在2027年二季度正式进行实物发布。

此外，无锡沐创集成电路灵晓LINX400G智算网卡，至讯创新科技的SLC NAND、MLC NAND存储芯片等多个“无锡造”芯片产品也在现场亮相。苏服云(江苏)科技有限公司发布了边缘AI芯片、数据中心AI高性能芯片、专用AI芯片等产品需求；江苏中科同芯就一款端侧轻量AI的外围模组需求，一款AI工作站所需GPU、工作站级存储模组等公开寻找“合作伙伴”。

(韩依纯)

滨湖“芯”势力迈向“构建生态”

本报讯 8月31日，作为2026集成电路(无锡)创新发展大会四大专题活动之一，第八届太湖芯芯会议在滨湖区启幕。会议释放出明确的产业信号：以蠡园开发区为核心的滨湖“芯”势力，正加速实现从“主打设计”到“构建生态”的战略进阶。

会议锚定AI互联、先进封装两大核心赛道，全国200余位院士专家、行业协会代表、龙头企业负责人及投融资机构精英齐聚一堂，共商泛AI芯片创新发展路径。不同于传统的技术研讨或招商推介，本次会议更像是一份精心谋划的“产业生态宣言”，核心指向构建算力、存储、互联等泛AI芯片领域，覆盖设计、制造、封测到应用的全链条产业生态。

会上，3项集成电路团体标准集中发布。这批标准由中科芯、江苏睿芯源、江苏集萃分别牵头编制，覆盖新能源车动力电池管理系统、无轴承编码器、射频器件参数测试三大细分领域。此外，江苏省集成电路学会成果评价与转化工作委员会正式揭牌，

依托省级专业平台，建立健全芯片技术价值评估体系，着力破解高校科研成果产业化的堵点难点，让创新成果真正从实验室走向生产线。

一批硬核技术成果也在会上集中亮相，展现出滨湖“芯”产业的硬核实力。无锡沐创集成电路推出国产抗量子安全AI芯片，填补国内安全芯片适配通用AI场景的技术空白；妙芯微电子发布AgiLink AI互联平台，提供全链路互联系统解决方案；惠然微电子成功研制14/22nm制程CD-SEM量测设备，破解先进制程晶圆在线量测“卡脖子”难题。

会议发布《AI互联：系统创新重构算力产业新格局》产业报告，创新性引入“锲定律”研究方法论，结合抗量子安全AI芯片、AI互联IP方案等最新产品成果，直击AI时代算力发展核心瓶颈。会上，“芯智协同生态共建”正式启动，聚焦泛AI芯片全链条发展，推动集成电路与人工智能深度跨域联动，加快构筑共生共荣的产业发展新格局。(邵旭根、徐晴雨)

继首拍西藏灾后影像后

“无锡星”接续观测

本报讯 继首拍西藏吉隆口岸灾后影像后，梁溪落地企业天仪空间连日来联动中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国地质大学(武汉)等多方力量，开启多星接续监测模式，依托SAR卫星全天时、全天候、可穿透云雾的独特优势，持续对灾区开展动态遥感监测，为抢险救灾提供稳定遥感数据支撑。

吉隆灾区山高谷深，气象条件复杂，云雾、降雨持续干扰常规光学遥感观测，给灾情排查带来不小挑战。8月27日凌晨，“电建一号”率先传回首批灾后SAR影像，技术人员据此初步识别河道堵塞堆积体与堰塞湖险情，为前线应急救援送上第一手灾情依据。为补齐观测

盲区、动态追踪险情变化，8月28日监测团队启动多星连续过境组网观测，通过多角度、多时段成像实现交叉验证，补齐单一卫星观测存在的视野短板。

8月28日12时41分、13时50分，“神启号02星”与“电建一号”先后完成过境成像。依托最新回传影像译解分析，监测团队在灾害路径上游新识别一处堰塞湖。该点位紧邻本次灾害上游尼泊尔境内冰岩崩塌源区。卫星影像中，湖体呈现封闭状暗色调区域，轮廓清晰、形态完整，具备典型的崩塌堆积物堵塞沟谷、蓄水成湖特征。相关技术人员研判，此处堰塞湖形成于高位沟谷区域，堰塞坝由松散堆积物质构成，稳定性较差，

存在溃决风险，极易诱发次生灾害，需要持续重点关注。

当日23时56分，“巢湖一号”卫星接续开展灾区应急观测，获取吉隆口岸及周边灾害影响区域高分辨率SAR影像。本次夜间观测一方面对堰塞湖01、堰塞湖02以及整条泥石流受灾路径开展复核确认；另一方面，观测范围覆盖吉隆口岸与G216抢险救援通道。技术人员借助SAR回波特征，清晰识别道路抢通线路以及现场机械开挖作业痕迹，直观呈现当前抢险施工推进情况，充分展现SAR卫星在复杂气象条件下，服务灾情研判、支撑抢险决策的重要价值。

(蔡佳)

干部任前公示

朱晓峰，男，汉族，1983年9月生，大学，中共党员，现任新吴区委常委，无锡高新技术产业开发区党工委委员，拟任国家级开发区正处级干部。

华艳红，女，汉族，1975年7月生，大学，中共党员，现任新吴区委常委，副区长、政府党组副书记，无锡高新技术产业开发区党工委委员，拟任国家级开发区正处级干部。

沈薇，女，汉族，1972年6月生，博士研究生，民建会员，现任新吴区副区长、三级调研员，民建无锡市委员会副主委(兼)、新吴区基层委员会主委，拟任国家级开发区正处级干部。

王学君，男，汉族，1978年6月生，省委党校研究生，中共党员，现任宜兴市副处级干部，市对口帮扶延安市长阳县联络员，延长县委常委、副县长(挂职)，拟推荐提名为副市(县)区长人选。

程伟，男，汉族，1979年12月生，大学，中共党员，现任梁溪区清名桥街道党工委书记，无锡江南古运河旅游度假区管理办公室党委委员，拟推荐提名为副市(县)区长人选。

王文峰，男，汉族，1981年2月

生，大学，中共党员，现任惠山区发展和改革委员会主任、党组书记，区粮食和物资储备局局长，区国防动员办公室(区人民防空办公室)主任，新吴区旺庄街道党工委副书记，拟推荐提名为副市(县)区长人选。

朱岩，男，汉族，1978年4月生，省委党校研究生，中共党员，现任无锡太湖国家旅游度假区党工委委员、管委会副主任，市对口帮扶海东市民和县联络员，民和县县委常委、副县长(挂职)，拟推荐提名为副市(县)区长人选。

黄锡渭，男，汉族，1979年5月生，大学，中共党员，现任无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室副主任，无锡新加坡科创城党工委副书记、管理办公室主任，新吴区旺庄街道党工委副书记，拟推荐提名为副市(县)区长人选。

公示时间为：2026年9月1日至9月7日。对公示对象有何反映，请于公示期间与市委组织部干部监督科联系。联系电话：0510-12380-0。联系地址：无锡市观山路199号市委组织部干部监督科(邮编：214131)。

中共无锡市委组织部
2026年8月31日

(上接第1版)与会嘉宾在大会开幕前参观了半导体设备材料及核心部件展。在无锡期间，刘小涛调研了星驱科技公司、蓝箭航天科技公司。

省有关部门单位和设区市负责同志，

无锡市领导刘建东、王凯、方力、周文栋、孙玮，华虹宏力、曙光信息、中航科创、阶跃星辰、华为、中国电子科技集团、中电科电子装备集团、新紫光集团、华润微、盛合晶微、摩尔线程、沐曦股份等业界知名企

业代表和市国联集团、交通集团、市政集团、产业集团、城建发集团、太湖新城集团、跃星辰、华为、中国电子科技集团、中电科电子装备集团、新紫光集团、华润微、盛合晶微、摩尔线程、沐曦股份等业界知名企

(陈青青)